

セミコン・ジャパン2012のご案内

2012年11月吉日

お客様各位

日本電子材料株式会社
営業統括部長 岩下 俊治

拝啓

貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

本年も例年同様、業界最大のイベントであるセミコンジャパン 2012 に出展いたします。
多様化するウェハ・テストに向けてプロービングの技術向上をお客様と共に実現したいと考えております。弊社が数年来掲げております「*Your Probing Partner*」を合言葉に、お客様に信頼され、期待に応えるべく大いなる創造力を確かな技術に結びつけていきます。

ご多忙のこととは存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 期間 2012年12月5日(水) ～ 7日(金)
2. 場所 幕張メッセ
3. ブース 6A-301
4. 出展品

MEMSタイプ

- MCシリーズ 狭ピッチを実現した300mmウェハ一括対応のプローブカード

Verticalタイプ

- VCシリーズ 100umピッチ以上の300mmウェハ一括対応のプローブカード
- VTシリーズ 狭ピッチ、マルチレイアウト対応のプローブカード
- VSシリーズ ポゴピン型、Flip Chip、WLCSP対応のプローブカード
- VEシリーズ カンチレバー型、マルチレイアウト対応のプローブカード

Cantileverタイプ

- CNシリーズ 電気的特性に優れ、メンテナンス性を向上させたプローブカード

高周波タイプ

- RF対応プローブカード

MEMSタイプの新技術

- 高密度ST
- 高密度Flip Chip向けMEMSプローブ
- DCパラメトリック向けプローブヘッド



Your Probing Partner